

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年10月16日 (2014.10.16)

【公開番号】特開2013-58663(P2013-58663A)

【公開日】平成25年3月28日 (2013.3.28)

【年通号数】公開・登録公報2013-015

【出願番号】特願2011-196819(P2011-196819)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

H 0 5 K 3/34 (2006.01)

H 0 5 K 3/30 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/02 C

H 0 5 K 3/34

H 0 5 K 3/30

H 0 5 K 1/02 F

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月2日 (2014.9.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

穴が形成された基板と、
前記基板の表面のうち、前記穴の少なくとも一部を含む第 1 領域に接合されるイメージ
ャと
を備える回路基板。

【請求項 2】

前記基板の裏面のうち、前記穴の少なくとも一部を含む第 2 領域に、第 1 の温度調整部
材、又は第 2 の温度調整部材が装着される
請求項 1 に記載の回路基板。

【請求項 3】

前記イメージャの裏面と前記第 1 の温度調整部材又は前記第 2 の温度調整部材との間に
、さらに、第 3 の温度調整部材が挿入される
請求項 2 に記載の回路基板。

【請求項 4】

前記第 3 の温度調整部材は、弾性体の熱伝導体シートを含む
請求項 3 に記載の回路基板。

【請求項 5】

前記第 3 の温度調整部材は、熱伝導グリスを含む
請求項 3 に記載の回路基板。

【請求項 6】

前記第 1 の温度調整部材は、温度センサを挿入する挿入孔を有するヒートシンクである
請求項 2 乃至 5 のいずれか に記載の回路基板。

【請求項 7】

前記第 2 領域に装着された前記第 2 の温度調整部材を、前記第 2 領域に圧着する弾性体

をさらに備える

請求項 2 乃至 6 のいずれか に記載の回路基板。

【請求項 8】

前記第 2 の温度調整部材は、温度センサを挿入する挿入孔を有する温度調整プレートを含む

請求項 2 乃至 7 のいずれか に記載の回路基板。

【請求項 9】

前記基板と前記イメージャは、半田及び樹脂により接合されている

請求項 1 乃至 8 のいずれか に記載の回路基板。

【請求項 10】

前記第 1 領域に接合された前記イメージャを、前記第 1 領域に固定する固定用部材をさらに備える

請求項 1 乃至 9 のいずれか に記載の回路基板。